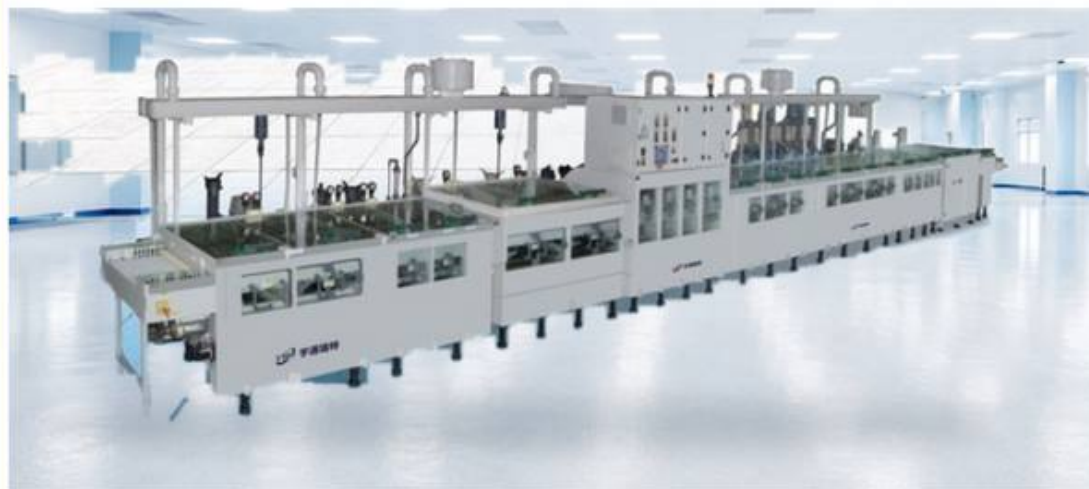


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Горизонтальные и вертикальные линии мокрых процессов
для PCB, FPCB, керамических подложек и полупроводников.



НАДЁЖНОСТЬ

Стабильные процессы

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Интеграция с MES

СЕРВИС

Поддержка и обучение

ЛИНИЯ ПОДГОТОВКИ ВНУТРЕННИХ СЛОЁВ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Равномерная транспортировка плат толщиной от 0,04 мм.
- Микротравильная подготовка медной поверхности.
- Энергоэффективные приводы класса IE3/IE4.
- Автоматический контроль воды и химических растворов.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Подготовка меди внутренних слоёв перед оксидированием и прессованием.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ



КОРИЧНЕВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ

07



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подвижные ролики защищают поверхность платы.
- Коррозионностойкие ролики с равномерным прижимом.
- Водяной нож и ванна обеспечивают равномерную обработку.
- Антистатическая защита без повреждения платы.
- Интеграция с MES.

НАЗНАЧЕНИЕ

Формирование адгезионного слоя на меди перед прессованием многослойной PCB.

ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

